

聯茂電子股份有限公司

企業獎助學金暨人才培育合作計畫

Innovation, Teamwork, Excellence, Quality

聯茂電子獎助學金專案

贏在起跑點，獎的就是你！

- 招募對象：大三、大四、碩一、碩二在校生。
- 科系：化學系、化工系、材料科學工程系、其他理工學系均可報名參與評選。
- 資格條件：
 1. 每學期平均成績70分以上。
 2. 操性成績80分以上。
 3. 未領取其他企業獎助學金者。
- 採『1:1』對等服務原則，即受領獎助學金之「學年總數」，應等同於其畢業或退伍後應至本公司履行服務之「年數」。
- 獎助學金標準：

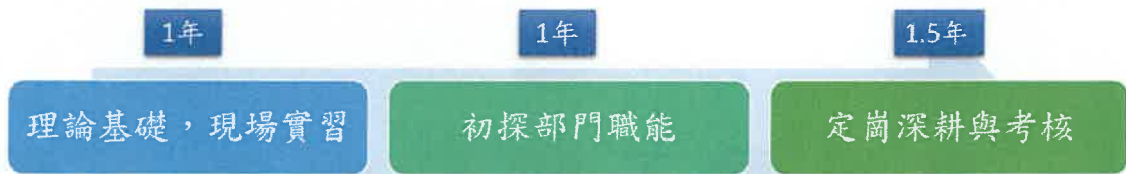
年級與獎助學金	大學部	研究所
每學期獎助學金	\$55,000	\$65,000
每月零用金	\$3,000	\$5,000

- 獎助學金於雙方簽約後20日內撥款至獎助金提供之帳戶。

Innovation, Teamwork, Excellence, Quality

聯茂電子獎助學金專案

培育方向及規劃



項目	第一階段	第二階段	第三階段
期間	1年	1年	1.5年
部門	不分部門，全員至現場分組實際操作；利用業餘空檔時間學習理論基礎。	依現場實習表現，進行初步分組至研發、製工，或製造。	續定最終留任部門，進行「準員工級」的獨立作業與績效驗證。
培訓重點	此階段將搭配理論基礎之課程，藉由現場實務驗證，了解所有工序及其原理。	<ol style="list-style-type: none"> 參加部門專案，擔任「執行者」角色。 參加部門內部技術研討會或教育訓練。 	<ol style="list-style-type: none"> 獨立負責專案，由導師(Mentor)交派一個完整的子計劃，讓學員從規劃、執行到成果發表獨立完成。 結訓檢定：包含專案知識筆試與工作心得專案報告。
工作時間	比照現場，做四休二，12H/日	依各部門安排，有兩種班別： <ol style="list-style-type: none"> 做四休二，12H/日 周休二日，8H/日 	依各部門安排，有兩種班別： <ol style="list-style-type: none"> 做四休二，12H/日 周休二日，8H/日
薪碼	比照儲幹待遇，以年薪計 學士：平均月薪65,000以上 碩士：平均月薪72,500以上	依工作考核，配合公司調薪政策	依工作考核，配合公司調薪政策

Innovation, Teamwork, Excellence, Quality

聯茂電子獎助學金專案

報名備審文件

申請資料準備與繳交須知

一、繳交方式

請掃描下方QR Code 進入申請系統，在系統內填寫基本履歷資料，並將所有應備文件掃描成PDF檔後上傳。

二、應備文件清單(PDF格式)

請注意：所有檔案(含其他有利審查資料)統一命名格式為：學校系所-學號-姓名-文件名稱

(範例：台灣大學中文系-B12345678-王小明-在學證明及歷年成績單.pdf)

- 在學證明及歷年成績單
 - 需包含學校官方戳章。
- 學生證影本
 - 需含註冊章或當學期在學證明。
- 學生證正反面影本
 - 需清晰可辨識個人資訊。
- 其他有利審查資料
 - 請務必遵循上述命名規範。
 - 例如：語言檢定(英檢/多益)、專業證照、獲獎紀錄、社團參與或志工服務證明。



三、重要注意事項

公告通知：錄取或面試名單將公告於官方網站，請自行留意。

逾期不受理：務必於截止日期前完成上傳。若資料不全、命名格式錯誤或逾期提交，將視同放棄資格。

Innovation, Teamwork, Excellence, Quality

聯茂電子獎助學金專案

預聘專案作業時程

Item	7/M	8/B	8/M	9/B	9/M	9/E	10/M	10/E	11/M	12/B	12/M	12/E
履歷收件												
履歷篩選												
面談環結												
複試(if necessary)												
內部審議												
公告結果												
簽約完成												

- 採一年一簽；獎助生應於每學期開學後15日內主動聯繫聯茂電子精英預聘專案窗口，並將成績單及在學證明影本寄送本公司指定窗口。
- 若獎助生因未達續約門檻而無法續簽者，本公司停止後續獎助撥付義務。獎助生無需返還先前已受領之獎助款項，惟仍須履行與「已領取獎助學年數」相等之服務年限。
- 本專案溯及當學年第一學期開始月生效，溯及期間應發之獎助學金及零用金，將於簽約後20日內一併撥款至獎助生提供之帳戶。
- 獎助生應於畢業或退伍後15日內郵寄畢業證或退伍令影本通知人資窗口，以利本公司安排後續聘用事宜。

Innovation, Teamwork, Excellence, Quality

聯茂電子獎助學金專案

關於聯茂

【領航全球高速材料：聯茂電子】

聯茂電子 (ITEQ) 為全球前五大銅箔基板 (CCL) 大廠，更是國內高頻高速、無鹵材料供應鏈的領航者。我們憑藉低損耗材料的技術突破，成功搶進美系 AI 伺服器、800G 交換器及低軌衛星市場，並深度布局 車用電子 等高階應用領域。面對 AI 運算與次世代通訊革命，聯茂將持續領先業界定義材料標準，實現多元化的科技願景。

加入聯茂預聘菁英計畫，你將在具備全球競爭力的舞台上，親手將個人潛力轉化為驅動未來科技發展的核心動力。

官網: www.iteqcorp.com.tw

預聘專案聯繫窗口: (03) 588-7888 ext. 7095 HR陳小姐

ITEQ

**ITEQ is defining the future of AI — and
we've been waiting for YOU to lead it.**

Apply Now!

Thanks!

ITEQ

Innovation, Teamwork, Excellence, Quality

XP250030

2025 / 05 / 06 09 : 19

XN21002